

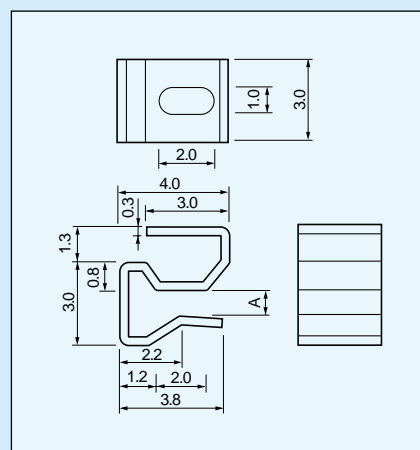
## サイドソケット【ECシリーズ】1パック100本入)

PAT

- 表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。
- 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。
- プリント基板の板厚によって6種類用意しています。
- 材質.....リン青銅
- 処理.....EC - - G...ニッケル下地金メッキ  
EC - - S...ニッケル下地スズメッキ
- 電流容量.....8A
- 接触抵抗.....20mΩ以下
- 挿入力.....800g以下
- 抜去力.....100g以上
- 挿抜回数.....100回以下
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 150



## 寸法図



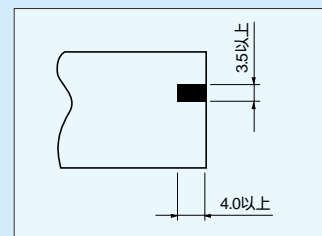
## 使用例



## 品番

品番	A	適合プリント板厚(mm)	メッキ
EC-0.2-G	0.1	0.2	金
EC-0.2-S	0.1	0.2	スズ
EC-0.6-G	0.4	0.6	金
EC-0.6-S	0.4	0.6	スズ
EC-0.8-G	0.6	0.8	金
EC-0.8-S	0.6	0.8	スズ
EC-1.0-G	0.8	1.0	金
EC-1.0-S	0.8	1.0	スズ
EC-1.2-G	1.0	1.2	金
EC-1.2-S	1.0	1.2	スズ
EC-1.6-G	1.4	1.6	金
EC-1.6-S	1.4	1.6	スズ

## 推奨ランド径



- 両面、片面ランドどちらでもOKです。  
(半田、金メッキランドに限る)  
(銅メッキランドには使用しないで下さい。  
ただし半田する場合は問題ありません。)